

2013年9月28日
生産本部資材統括部
品質保証本部 製品環境品質G

構成表・分析報告書について

1.構成表について

構成表とは (構成表のご要求事項)

購入製品情報					
No.	サンケン品番	品名	貴社品番(型名)	製品質量mg	貴社情報
1	34*****	ダイオード	1S***SY	130	右の通り

作成日
貴社名
担当部署名
ご担当者名
責任者職位
責任者名及び捺印又は、署名
電話番号
メールアドレス

構成部位(構成表)						
No.	構成部位の名称	製造メーカー/原産国	SONY GP原料		部位質量mg	部位質量比%
			GB番号	GP原料メーカーID		
1	外装樹脂	◆●化学/日本	GB No.*****	ID No.****	39	30%
2	リードフレーム	非開示/非開示	-	-	88.775	68%
3	端子メッキ	○■金属/日本	-	-	0.8	1%
4	シリコンチップ	○○電子/台湾	-	-	0.125	0%
5	チップ接続	○■金属/日本	-	-	1.3	1%
部位合計質量(貴社製品質量と一致する)					130	100%

- ・構成部位名は?
- ・その質量は?
- ・購入先は?(メーカー名、原産国)
- ・SONY推奨品(マグネットワイヤー、インク、塗料、成形樹脂等)、認定品(再生樹脂、被覆電線)ですか?

- ・各部位を構成する物質は?(物質名、CAS No.)
- ・成分質量は?
- ・使用目的は?
- ・環境規制に適合していますか?

No.	構成部位の名称	物質名	CAS No.	部位組成比%	成分質量mg	使用目的	備考(RoHS適用除外用途など)
1	外装樹脂	エポキシ樹脂	-	98	38.22	封止材	
		三酸化アンチモン	1309-64-4	1	0.39	難燃剤	
		その他臭素系難燃剤	-	1	0.39	難燃剤	RoHS禁止物質ではない
2	リードフレーム	銅	7440-50-8	99	87.88725	基材	
		不純物	-	1	0.88775	不純物	
3	端子メッキ	錫	7440-31-5	96.5	0.772	はんだ主成分	
		銀	7440-22-4	3	0.024	はんだ主成分	
		銅	7440-50-8	0.5	0.004	はんだ主成分	
4	シリコンチップ	珪素	7440-21-3	99.975	0.12496875	主成分	
		砒素	7440-38-2	0.025	0.00003125	ドーパント	
5	チップ接続	錫	7440-31-5	2.5	0.0325	高融点半田主成分	
		鉛	7439-92-1	95	1.235	高融点半田主成分	RoHS適用除外7(a)
		銀	7440-22-4	2.5	0.0325	高融点半田主成分	
成分合計質量(貴社製品質量と一致する)					130		

- 留意点**
- ・化学物質の質量合計は、製品質量に一致すること
 - ※今後の管理・禁止物質増加に対応するため
 - ※非開示物質は、非開示と記載して下さい。但し、禁止・管理物質は、開示する
 - ・適用除外用途には、期限付きのものがあります

2.分析報告書について

2-1.分析結果報告書注意事項

- a)分析前処理及び測定法はIEC62321に準拠し実施して下さい。
- b)分析に於ける処理フロー図を必ず添付して下さい。
- c)分析したサンプルの写真を必ず添付して下さい。
- d)分析データの有効期限は測定日より1年間です。測定日より1年以内の分析データを提出して下さい。

2-3.分析機関注意事項

- a)分析機関はSGS,INTERTEC等の国際的な分析機関か、ISO/IEC17025の認証を取得している機関を利用して下さい。
- b)SGS TAIWANの分析データの場合、1ページ目左上のマークに「？」が有る場合、データとして受付られません。ご注意願います。



3.RoHS6物質 高精度分析結果一覧表について

・以下の項目が記載された書面をご提出頂ければ、「RoHS6物質 高精度分析結果一覧表」の提出は不要です。

a)構成部位と分析結果報告書の突き合せが出来る事

b)構成部位の名称/材料名/材料メーカー/原産国/分析レポートナンバーが記されている事(但し、メーカー、原産国については、非開示、社外秘を認めます)

記載例

構成部位の名称	材料名	製造メーカー	原産国	分析レポートナンバー
外装樹脂	エポキシ樹脂	◆●化学	日本	2013/**/**
リードフレーム	Cu	非開示	非開示	JP/2013/**
端子メッキ	Sn-Cu	○■金属	日本	D/**/**
シリコンチップ	Si	○○電子	台湾	KA/2012/**
チップ接続	Sn-Pb	○■金属	日本	JP/2013/**

以上